

关于高端集成电路载板及先进封装基地（一期）环境保护措施竣工的公告

我单位建设的高端集成电路载板及先进封装基地（一期）环境保护措施已于 2023 年 5 月 1 日竣工，特此公告。

礼鼎半导体科技（深圳）有限公司

2023 年 5 月 1 日



关于高端集成电路载板及先进封装基地（一期）环境保护措施调试的公告

我单位建设的高端集成电路载板及先进封装基地（一期）环境保护措施已建成，拟于2023年5月1日~6月30日进行调试，特此公告。

礼鼎半导体科技（深圳）有限公司

2023年5月1日

